(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2004 年3 月11 日 (11.03.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/021435 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 23/28

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/010696

(22) 国際出願日: 2003 年8 月25 日 (25.08.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-250900 2002 年8 月29 日 (29.08.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真１００６番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 恒岡 道朗 (TSUNEOKA,Michiaki) [JP/JP]; 〒567-0821 大阪府 茨木市末広町 4－２０ Osaka (JP). 橋本 興二 (HASHIMOTO,Koji) [JP/JP]; 〒658-0021 兵庫県 神戸市東灘区深江本町 １－１３－２６ Hyogo (JP). 葉山 雅昭 (HAYAMA,Masaaki) [JP/JP]; 〒631-0817 奈良県 奈良市西大寺北町 １－６－１３－９０４ Nara (JP). 安保 武雄 (YASUHO,Takeo) [JP/JP]; 〒572-0051 大阪府 寝屋川市 高柳５－４８－１２ Osaka (JP).

(74) 代理人: 岩橋 文雄, 外(IWAHASHI,Fumio et al.); 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真１００６番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, SG, US.

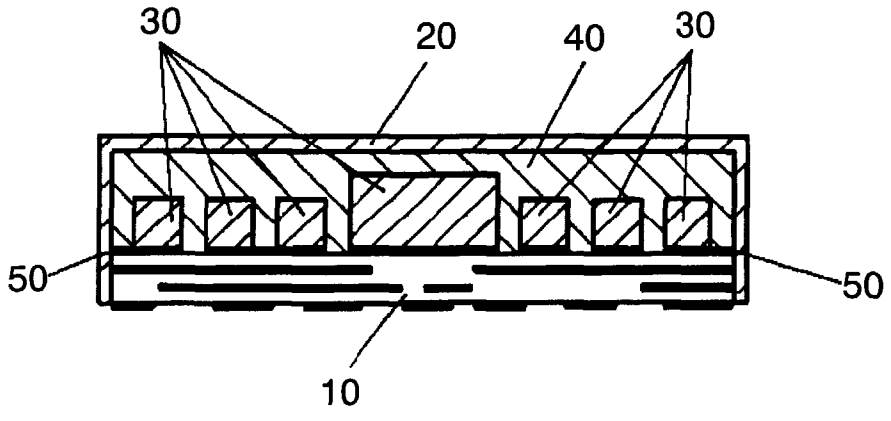
(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: MODULE PART

(54) 発明の名称: モジュール部品



(57) Abstract: A low-profile module part having an adequate shield effect. Mounting parts (30) composed of electronic parts are mounted on a circuit substrate (10), and the mounting parts (30) are encapsulated with an encapsulant (40). A metal film (20) is formed on the surface of this encapsulant (40). A ground pattern (50) is formed along the periphery of the surface of the circuit substrate (10), thereby electrically connecting the metal film (20) and the ground pattern (50).

(57) 要約: 充分なシールド効果を有する低背化されたモジュール部品を提供する。回路基板（１０）に電子部品からなる実装部品（３０）を搭載し、この実装部品（３０）を封止体（４０）で封止する。この封止体（４０）の表面上に金属膜（２０）を形成する。回路基板（１０）の表面の外周にグランドパターン（５０）を形成し、前記金属膜（２０）とグランドパターン（５０）とを導通させた構成とする。

WO 2004/021435 A1